03

Двухзонная проводимость Si₃N₄

© Ю.Н. Новиков

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова CO РАН, Новосибирск, Россия

E-mail: nov@isp.nsc.ru

(Поступила в Редакцию 28 ноября 2013 г.)

Теоретически изучена кинетика накопления заряда в структуре металл-нитрид кремния-оксид кремния-полупроводник. Результаты расчета сравниваются с экспериментальными данными. Для согласия теории с экспериментом в расчетах необходимо учитывать одновременно как перенос электронов, так и перенос дырок. Расчеты предсказывают, что сечение захвата носителей на ловушки должно быть менее $10^{-14}\,\mathrm{cm}^2$.

1. Введение

В электрических полях во многих диэлектриках, таких как Si_3N_4 , Al_2O_3 , HfO_2 , Ta_2O_5 и др., перенос заряда осуществляется с помощью глубоких центров — электронных и дырочных ловушек. Как правило, за исключением SiO₂, диэлектрики имеют высокую плотность ловушек (более $10^{19}\,\mathrm{cm}^{-3}$). Ловушки в $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$ способны захватывать и хранить заряд в локализованном состоянии в течение 10 лет [1]. В настоящее время Si₃N₄ активно используется во ФЛЭШ-элементах памяти в качестве "запоминающей" среды [1]. Проводимость, обусловленная одним типом носителей, называется однозонной. Если в переносе заряда участвуют как электроны, так и дырки, проводимость называется двухзонной. Выбор при описании эксперимента между однозонной и двухзонной моделью определяется инжектирующими свойствами контактов. Инжектирующие свойства контактов, в основном, определяются величиной энергетического барьера металл/диэлектрик, полупроводник/диэлектрик. Так, например, в работах [2,3] перенос заряда в Al₂O₃, HfO₂ осуществляется преимущественно электронами, так как инжекция дырок блокируется из-за большого энергетического барьера на границе Al_2O_3/Al ($\sim 4 \, eV$) [2] и HfO_2/TiN ($\sim 2.7\,eV$) [3]. Перенос заряда в Si_3N_4 интерпретируется в терминах как однозонной [4-9], так и двухзонной проводимости [10–14]. Однако, например, величины токов (в вольт-амперных или температурных зависимостях) при описании их с использованием однозонной [4] или двухзонной [10] модели отличаются друг от друга (при прочих равных условиях) в $\sim 1.5 - 2$ раза. Это отличие мало по сравнению с экспоненциальной зависимостью тока от электрического поля и температуры. Поэтому при интерпретации многих экспериментальных результатов вопрос об использовании однозонной или двухзонной модели в Si₃N₄ не является принципиальным. Однако существуют эксперименты [15], которые невозможно интерпретировать в рамках однозонной модели.

Цель работы показать, что в общем случае проводимость Si_3N_4 является двухзонной. Для этого выполняются расчеты по накоплению заряда (чему соот-

ветствует изменение напряжения плоских зон $U_{\rm FB}(t)$) в структуре металл-нитрид кремния-оксид кремнияполупроводник (МНОП) при положительном потенциале на металле (Au). Результаты расчета сопоставляются с экспериментом. Используется следующая геометрия МНОП-структуры [15]: SiO_2 — 5.5 nm, Si_3N_4 — 23 и 67 nm. Барьер для дырок на границе Au/Si₃N₄ составляет 1.5 eV [16]. Для такой (малой) величины потенциального барьера в переносе заряда в МНОП-структуре важную роль играют дырки. Дыркам необходимо пройти через весь образец Si₃N₄, чтобы дать заметный вклад в величину $U_{\rm FB}(t)$. Одним из основных параметров при проектировании ФЛЭШ-памяти, основанной на Si_3N_4 , является сечение захвата носителей. На сегодняшний день нет единого мнения по поводу величины сечения захвата для электронов (дырок) в Si₃N₄. В литературе для сечения захвата в Si_3N_4 приведены следующие значения: для электронов (дырок) $5 \cdot 10^{-13} \, \text{cm}^2$ [5,6], для электронов $4.8 \cdot 10^{-16} \,\mathrm{cm}^2$ [9], $1 \cdot 10^{-16} \,\mathrm{cm}^2$ [17]. В настоящей работе предполагается, что величина сечения захвата для дырок может быть оценена более точно по сравнению с экспериментами, в которых инжекция дырок в МНОП-структурах происходит из Siподложки [5,6].

2. Модель

На рис. 1 представлена энергетическая диаграмма МНОП-структуры: a) без приложенного напряжения, b) при положительном потенциале на Au.

Для описания переноса заряда в Si_3N_4 с учетом двух-зонной модели численно самосогласованно решаются одномерные уравнения Шокли–Рида–Холла и уравнение Пуассона. Уравнение Пуассона учитывает неоднородное распределение электрического поля в Si_3N_4 . В работах по переносу заряда в Si_3N_4 значения параметров ловушек для электронов и дырок или совпадают (ловушки амфотерны), или очень близки [1,10-13]. В настоящей работе предполагается, что электронные и дырочные ловушки имеют одинаковые параметры: P — темп ионизации при заданных величинах электрического поля и температуры, N — концентрация, σ — сечение захвата,

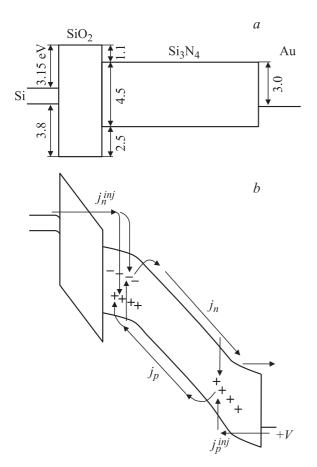


Рис. 1. Энергетическая диаграмма МНОП-структуры: (a) без приложенного напряжения, (b) при положительном потенциале на металлическом электроде.

 σ_r — сечение рекомбинации между свободными и захваченными на ловушку носителями противоположного знака. С учетом вышесказанного, для описания переноса заряда в Si_3N_4 используется следующая система уравнений [1,10,13]:

$$\frac{\partial n}{\partial t} - \frac{\partial n}{\partial x}v = -\sigma v n(N - n_t) + n_t P - \sigma_r v n p_t, \quad (1)$$

$$\frac{\partial n_t}{\partial t} = \sigma v n(N - n_t) - n_t P - \sigma_r v p n_t, \qquad (2)$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} - \frac{\partial p}{\partial x}v = -\sigma v p(N - p_t) + p_t P - \sigma_r v p n_t, \quad (3)$$

$$\frac{\partial p_t}{\partial t} = \sigma v p(N - p_t) - p_t P - \sigma_r v n p_t, \tag{4}$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = -e \, \frac{(n_t - p_t)}{\varepsilon_N \varepsilon_0}.\tag{5}$$

Здесь: n, n_t, p, p_t, P, F являются функциями координаты и времени: n и n_t — концентрации свободных и захваченных электронов, p и p_t — концентрации свободных и захваченных дырок, F — электрическое

поле, e — заряд электрона, ε_0 — электрическая постоянная. В расчетах используются следующие величины: $\sigma_r = 5 \cdot 10^{-13} \, \mathrm{cm}^2 \, [11], \ v = 10 \, \mathrm{cm/c}$ — дрейфовая скорость $[1,10,11], \ \varepsilon_N = 7.5$ — низкочастотная диэлектрическая проницаемость $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$.

В качестве граничного условия для уравнения (5) используется величина прикладываемого к МНОП-структуре импульса внешнего напряжения $U_{\rm Au}$; для уравнений (1)–(4) $n_0(t)=j_n^{inj}/ev,\,p_0(t)=j_p^{inj}/ev.$ Здесь $j_n^{inj},\,j_p^{inj}$ — инжекционные токи электронов из Si-подложки и дырок из Au, соответственно, которые рассчитывались на основе механизма Фаулера–Нордгейма с эффективной массой носителей в SiO2, равной $0.4m_0$ (здесь m_0 — масса свободного электрона). Для дырок вблизи границы Si3N4/SiO2 (рис. 1, b) используются следующие уравнения переноса:

$$\frac{\partial p}{\partial t} - \frac{\partial p}{\partial x}v = -\frac{pv}{\Lambda x} - \sigma_r v p n_t, \tag{6}$$

$$\frac{\partial p_t}{\partial t} = \frac{pv}{\Delta x} - \sigma_r v n p_t. \tag{7}$$

Здесь предполагается, что все дырки, дошедшие до границы Si_3N_4/SiO_2 , захватываются в тонком слое $\Delta x=1$ nm, так как они "наталкиваются" на потенциальный барьер ($\sim 4\,\mathrm{eV}$). Также в этом Δx -слое мы пренебрегаем ионизацией дырочных ловушек по причине большого для них ($\sim 4\,\mathrm{eV}$) энергетического барьера на границе Si_3N_4/SiO_2 (рис. 1, b).

Для расчета P используется теория многофононной ионизации ловушек. В рамках этой теории ловушка описывается некоторыми параметрами: энергия фонона $W_{\rm ph}=\hbar\omega$, термическая энергия W_T и оптическая энергия $W_{\rm opt}$. С учетом квантово-механического описания [18] для темпа ионизации ловушки используется следующее выражение:

$$P = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \exp\left[\frac{nW_{\rm ph}}{2kT} - S \coth\frac{W_{\rm ph}}{2kT}\right]$$

$$\times I_n\left(\frac{S}{\sinh(W_{\rm ph}/2kT)}\right) P_i(W_T + nW_{\rm ph}), \qquad (8)$$

$$S = \frac{W_{\rm opt} - W_T}{W_{\rm ph}},$$

$$P_i(W) = \frac{eF}{2\sqrt{2m^*W}} \exp\left(-\frac{4}{3} \frac{\sqrt{2m^*}}{\hbar eF} W^{3/2}\right),$$

здесь I_n — модифицированная функция Бесселя, m^* — эффективная масса носителя, k — постоянная Больцмана, \hbar — постоянная Планка. Этот механизм ионизации ловушек применялся для описания проводимости в Si_3N_4 [10,13], Al_2O_3 [2] и HfO_2 [3].

Кинетика накопления заряда (изменение со временем напряжения плоских зон) в МНОП-структуре рассчиты-

1048 Ю.Н. Новиков

вается по формуле [1]

$$U_{\rm FB}(t) = \frac{e}{\varepsilon_0 \varepsilon_N} \int_0^d dx (n_t - p_t)(d - x), \tag{9}$$

где d — толщина Si_3N_4 .

3. Сравнение эксперимента с расчетом, обсуждение

На рис. 2, a показан расчет (тонкие линии) экспериментальных зависимостей $U_{\rm FB}(t)$ с использованием следующих параметров ловушек: $m^*=0.5m_0,~W_T=1.4~{\rm eV},~W_{\rm opt}=2.6~{\rm eV},~W_{\rm ph}=0.06~{\rm eV},~N=7\cdot10^{19}~{\rm cm}^{-3},$ которые очень близки к параметрам ловушек, используемым в работах [10-13]. Для сечения захвата принимается величина $\sigma=5\cdot10^{-13}~{\rm cm}^2,$ определенная в работах [5,6]. Величина $\sigma=5\cdot10^{-13}~{\rm cm}^2,$ как установленный пара-

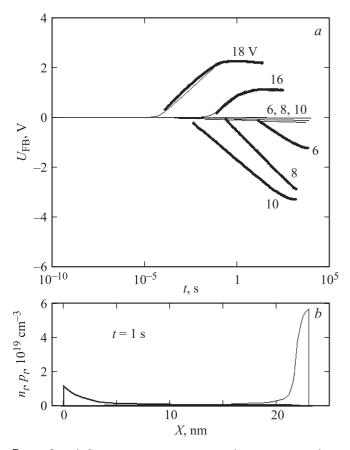


Рис. 2. *а*) Сравнение эксперимента (жирные линии) с расчетом (тонкие линии) кинетики накопления заряда в МНОП-структуре при положительном потенциале на Au. Параметры ловушек: $m^* = 0.5m_0$, $W_T = 1.4\,\mathrm{eV}$, $W_{\mathrm{opt}} = 2.6\,\mathrm{eV}$, $W_{\mathrm{ph}} = 0.06\,\mathrm{eV}$, $\sigma_r = 5\cdot 10^{-13}\,\mathrm{cm}^2$, $N = 7\cdot 10^{19}\,\mathrm{cm}^{-3}$, $\sigma = 5\cdot 10^{-13}\,\mathrm{cm}^2$. *b*) Распределение захваченных электронов (жирная линия) и дырок (тонкая линия) в Si₃N₄ при потенциале на Au, равном 10 V. Толщина Si₃N₄ — 23 nm, а SiO₂ — 5.5 nm.

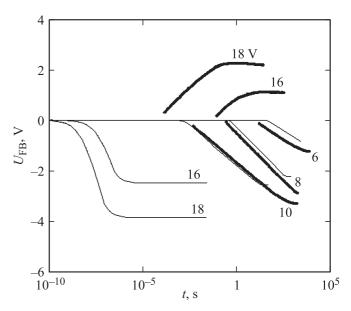


Рис. 3. Сравнение эксперимента (жирные линии) с расчетом (тонкие линии) кинетики накопления заряда в МНОП-структуре при положительном потенциале на Au. Параметры ловушек: $m^*=0.5m_0$, $W_T=1.4\,\mathrm{eV}$, $W_\mathrm{opt}=2.6\,\mathrm{eV}$, $W_\mathrm{ph}=0.06\,\mathrm{eV}$, $\sigma_r=5\cdot10^{-13}\,\mathrm{cm}^2$, $N=8.7\cdot10^{17}\,\mathrm{cm}^{-3}$, $\sigma=5\cdot10^{-13}\,\mathrm{cm}^2$. Толщина $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$ — 23 nm, а SiO_2 — 5.5 nm. В расчетах использовалось значение 1 nm для толщины слоя вблизи границы $\mathrm{SiO}_2/\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$ с избыточной концентрацией ловушек $(N^s=10^{22}\,\mathrm{cm}^{-3})$.

метр, наиболее часто используется в литературе [4,7,10-13,17]. Для описания положения центроида, захваченного заряда в МНОП-структуре, используется "длина захвата" $L=(1/N\sigma)$ [5,6]. В нашем случае для заданных N и σ получаем $L\sim 0.3\,\mathrm{nm}$. Из рис. 2, aвидно, что при $U_{\rm Au}=18-16\,{\rm V}$ эксперимент согласуется с расчетом. В то же время при $U_{\rm Au} = 10 - 6 \, {
m V}$ наблюдается расхождение между теорией и экспериментом — рассчитанные зависимости $U_{\rm FB}(t)$ намного меньше экспериментальных по величине (рис. 2, a). Это связано с тем, что дырки, захваченные вблизи границы Si_3N_4/Au , не дают вклада в $U_{FB}(t)$, так как их центроид расположен далеко от границы SiO_2/Si_3N_4 (рис. 2, b). Для того чтобы захваченные на ловушки дырки давали вклад в $U_{\rm FB}(t)$, необходимо, чтобы величина L для дырок была сравнима с толщиной пленки Si₃N₄ или превышала ее.

Предположим, что в пленке Si_3N_4 величина $\sigma=5\cdot 10^{-13}~\rm cm^2$, а концентрация ловушек мала. Оценка N для $L=23~\rm nm$ и $\sigma=5\cdot 10^{-13}~\rm cm^2$ дает $8.7\cdot 10^{17}~\rm cm^{-3}$. При условии, что все дырочные ловушки заполнены, а электронные нет, получаем $U_{\rm FB}(t)\sim 1~\rm V$, что меньше экспериментального значения. Можно предположить, что вблизи границы SiO_2/Si_3N_4 в тонком слое есть избыточная, по сравнению с объемом, концентрация электронных и дырочных ловушек ($N^s\sim 10^{22}~\rm cm^{-3}$). Ранее в работе [19] было

экспериментально доказано существование такого слоя порядка 1 nm. Здесь и далее будем считать, что толщина слоя с избыточной концентрацией ловушек равна Δx . Избыточная концентрация электронных и дырочных ловушек связывается с существованием избыточного кремния на границе $\mathrm{SiO}_2/\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$. В этом случае все процессы, ведущие к перезарядке МНОП-структуры, происходят в тонком слое вблизи границы $\mathrm{SiO}_2/\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$. Тогда для Δx -слоя из уравнений (2), (7) с учетом того, что $j_n^{inj} = evn, j_p^{inj} = evp$, можно записать:

$$\frac{\partial}{\partial t}(p_t - n_t) = \frac{j_p^{inj}}{e\Delta x} + n_t P$$

$$- \left[\frac{\sigma j_n^{inj}}{e}(N^s - n_t) + \sigma_r v(np_t - pn_t)\right]. \tag{10}$$

Анализ формулы (10) и численный расчет с параметрами ловушек из предыдущего расчета показывают (рис. 3, тонкая линия), что при $U_{\rm Au}=6-10\,{\rm V}$ наблюдается удовлетворительное согласие с экспериментом. При $U_{\rm Au}=16-18\,{\rm V}$ теория расходится с экспериментом. За малые времена $(10^{-6}\,{\rm s})$ дырки скапливаются вблизи границы ${\rm SiO_2/Si_3N_4}$, так как $j_n^{inj}>j_n^{inj}$. Скопление дырок вблизи границы ${\rm SiO_2/Si_3N_4}$ приводит к увеличению: электрического поля в ${\rm SiO_2}$, j_n^{inj} , P. Поэтому в начальные моменты времени значения $U_{\rm FB}(t)$ будут отрицательными, и будут уменьшаться до тех пор (тонкая линия на рис. 3), пока инжекционный ток электронов не уравновесит ток дырок и ионизацию электронных ловушек.

Из экспериментальных результатов [15] для МНОПструктуры с толстым (67 nm) слоем Si₃N₄ (расчеты будут представлены ниже) следует, что величина L для дырок меньше 67 nm, так как в этих экспериментах почти не наблюдаются отрицательные значения $U_{\rm FB}(t)$. Тогда для дырок $23 \, \mathrm{nm} \le L < 67 \, \mathrm{nm}$. Последнее условие означает, что захват дырок на ловушки вблизи границы SiO₂/Si₃N₄ будет преобладать над захватом электронов. Как показывает расчет, для любых U_{Au} будут наблюдаться только отрицательные значения $U_{\rm FB}(t)$. Для того чтобы теория описывала эксперимент, необходимо предположить существование слоя толщиной Δx с избыточной концентрацией ($\sim 10^{22}\,\mathrm{cm}^{-3}$) электронных (дырочных) ловушек вблизи границы SiO₂/Si₃N₄. В этом случае, согласно формулам (1), (2), захват электронов в слое с избыточной концентрацией ловушек увеличится, а захват дырок останется прежним (формулы (6), (7)). Наилучшее согласие между экспериментом и расчетом получено для $L=40\,\mathrm{nm}$. Из предыдущего расчета следует, что для того, чтобы объемные электронные ловушки давали значительный вклад в $U_{\rm FB}(t)$, их концентрация должна быть не менее $10^{19}\,\mathrm{cm}^{-3}$. Отсюда можно оценить максимально возможное сечение захвата $\sim 10^{-14}\,\mathrm{cm}^2.$ Из работы [8] для $N = 3 \cdot 10^{21} \, \mathrm{cm}^{-3}$ оценим минимальное значение для $\sigma \sim 10^{-16}\,\mathrm{cm}^2$. Данная методика не позволяет однозначно определить величины σ и N. Поэтому далее для сечения захвата будет принята величина

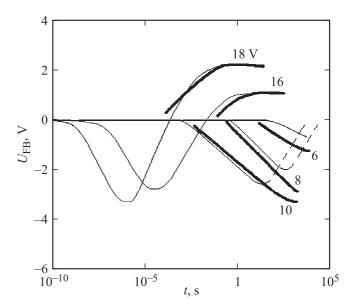


Рис. 4. Сравнение эксперимента (жирные линии) с расчетом (тонкие линии) кинетики накопления заряда в МНОП-структуре при положительном потенциале на Au. Параметры ловушек: $m^* = 0.4m_0$, $W_T = 1.6$ eV, $W_{\rm opt} = 3.2$ eV, $W_{\rm ph} = 0.06$ eV, $N = 5 \cdot 10^{20}$ cm $^{-3}$, $\sigma_r = 5 \cdot 10^{-13}$ cm 2 , $\sigma = 5 \cdot 10^{-16}$ cm 2 . Толщина Si₃N₄ 23 nm, а SiO₂ — 5.5 nm. В расчетах использовалось значение 1 nm для толщины слоя вблизи границы SiO₂/Si₃N₄ с избыточной концентрацией ловушек ($N^s = 10^{22}$ cm $^{-3}$).

 $\sigma=5\cdot 10^{-16}~{\rm cm}^2$, так как эта величина была получена в работе [17]. Значениям $\sigma=5\cdot 10^{-16}~{\rm cm}^2$ и $L=40~{\rm nm}$ соответствует $N=5\cdot 10^{20}~{\rm cm}^{-3}$.

На рис. 4 представлено сравнение экспериментальных зависимостей $U_{\rm FB}(t)$ (жирные линии) с расчетом (тонкие линии) при следующих параметрах ловушек: $m^* = 0.4m_0$, $W_T = 1.6 \text{ eV}$, $W_{\text{opt}} = 3.2 \text{ eV}$, $W_{\text{ph}} = 0.06 \text{ eV}$, $\sigma = 5 \cdot 10^{-16} \text{ cm}^2$, $N = 5 \cdot 10^{20} \text{ cm}^{-3}$, $N^s = 10^{22} \text{ cm}^{-3}$. При $U_{\rm Au} = 10-6 \, {\rm V}$ расчет удовлетворительно описывает эксперимент и предсказывает медленную релаксацию (пунктирная линия на рис. 4) в сторону положительных $U_{\rm FB}(t)$. Для $U_{\rm Au}=18{-}16\,{
m V}$ расчет предсказывает отрицательные значения $U_{\rm FB}(t)$ в начальные моменты времени ($\sim 10^{-6}\,{\rm s}$), так как $j_p^{inj}>j_n^{inj}$. В эксперименте этот факт не зафиксирован (рис. 4). Это противоречие, возможно, связано с низкой по времени разрешающей способностью аппаратуры, так как измерение CV-характеристик происходило на частоте $\sim 1\,\mathrm{MHz}$. На рис. 5 представлены зависимости n_t и p_t при $U_{\rm Au}=18\,{\rm V}$. Из рис. 5 следует, что в начальные моменты времени, после подачи поляризующего импульса, концентрация захваченных дырок вблизи границы SiO₂/Si₃N₄ значительно превышает концентрацию захваченных электронов (отрицательные значения $U_{\rm FB}(t)$). Далее концентрация захваченных дырок вблизи границы SiO₂/Si₃N₄ уменьшается (рис. 5) за счет рекомбинации их со свободными электронами, а концентрация захваченных электронов 1050 Ю.Н. Новиков

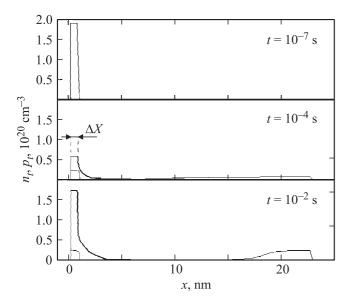


Рис. 5. Распределение захваченных на ловушки электронов (жирные линия) и дырок (тонкая линия) в Si_3N_4 при потенциале на Au-электроде, равном 18 V, в различные моменты времени.

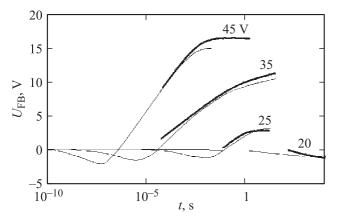


Рис. 6. Сравнение эксперимента (жирные линии) с расчетом (тонкие линии) кинетики накопления заряда в МНОП-структуре при положительном потенциале на Au. Параметры ловушек: $m^*=0.4m_0,\ W_T=1.6\ {\rm eV},\ W_{\rm opt}=3.2\ {\rm eV},\ W_{\rm ph}=0.06\ {\rm eV},\quad \sigma_r=5\cdot 10^{-13}\ {\rm cm}^2,\quad N=5\cdot 10^{20}\ {\rm cm}^{-3},\ \sigma=5\cdot 10^{-16}\ {\rm cm}^2.$ Толщина Si₃N₄ 67 nm, а SiO₂ — 5.5 nm. В расчетах использовалось значение 1 nm для толщины слоя вблизи границы SiO₂/Si₃N₄ с избыточной концентрацией ловушек ($N^s=10^{22}\ {\rm cm}^{-3}$).

возрастает. В отличие от предыдущего расчета (на рис. 3), здесь значительная часть электронов захватывается на ловушки в объеме $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$.

На рис. 6 представлено сравнение экспериментальных зависимостей $U_{\rm FB}(t)$ (жирные линии), взятых из [15], для МНОП-структуры с толщиной ${\rm Si_3N_4}$, равной 67 nm, с расчетом (тонкие линии). Параметры ловушек взяты из предыдущего расчета (рис. 4). Рассчитанные кривые удовлетворительно описывают экспериментальные дан-

ные. Так же как и в предыдущем случае, расчет предсказывает в начальные моменты времени, после подачи поляризующего импульса, небольшое накопление дырок в МНОП-структуре (отрицательные значения $U_{\rm FB}(t)$).

Расхождение в величине сечения захвата, полученного в настоящей работе, с работами, где оно оценивалось как $5 \cdot 10^{-13} \, \text{cm}^2$ [5,6], в основном связано с тем, что в этих работах не учитывался двузонный характер проводимости в Si₃N₄. В работах [5,6] в МНОП-структурах при положительном потенциале на А1 пренебрегали инжекцией дырок из Al, а при отрицательном потенциале — инжекцией электронов. Однако в работе [14] было показано, что инжекция дырок из А1 при положительном потенциале на нем является значительной. В настоящей работе использовалась теория многофононной ионизации для нейтральных ловушек. Получены разумные физические параметры ловушек. Наиболее вероятным представляется захват электронов (дырок) в Si₃N₄ на нейтральную Si-Si связь с участием поляронного эффекта [20].

4. Выводы

В работе показано, что проводимость Si_3N_4 в общем случае носит сугубо двухзонный характер — в переносе заряда одновременно участвуют как электроны, так и дырки. Определены параметры глубоких центров в Si_3N_4 : $W_T=1.6\,\mathrm{eV},~W_\mathrm{opt}=3.2\,\mathrm{eV},~W_\mathrm{ph}=0.06\,\mathrm{eV}$ и $m^*=0.4m_e$. Согласие теории с экспериментом наблюдается при значениях сечения захвата электронов и дырок на ловушки менее $10^{-14}\,\mathrm{cm}^2$ и концентрации ловушек более $10^{19}\,\mathrm{cm}^{-3}$. С учетом амфотерности ловушек, проведенные в настоящей работе расчеты предсказывают существование вблизи границы SiO_2/Si_3N_4 слоя с избыточной концентрацией ловушек, что является независимым теоретическим подтверждением гипотезы [19].

Список литературы

- [1] Yu.N. Novikov. The FLASH Memory Based on Silicon Nitride (SONOS). Nova Publisher, N.Y. (2011). P. 35.
- [2] Ю.Н. Новиков, В.А. Гриценко, К.А. Насыров. Письма в ЖЭТФ **89**, 599 (2009).
- [3] Yu.N. Novikov. J. Appl. Phys. 113, 024109 (2013).
- [4] K.A. Nasyrov, V.A. Gritsenko, M.K. Kim, H.S. Chae, S.D. Chae, W.I. Ryu, J.H. Sok, J.W. Lee, B.M. Kim. IEEE Electron Device Lett. 23, 336 (2002).
- [5] P.C. Arnett, B.H. Yan. Appl. Phys. Lett. 26, 94 (1975).
- [6] F.L. Hampton, J.R. Cricchi. Appl. Phys. Lett. 35, 802 (1979).
- [7] S. Manzini. J. Appl. Phys. 62, 3278 (1987).
- [8] К.А. Насыров, В.А. Гриценко. ЖЭТФ **139**, 1172 (2011).
- [9] Y.C. Jeon, H.Y. Lee, S.K. Joo. J. Appl. Phys. 75, 979 (1993).
- [10] K.A. Nasyrov, V.A. Gritsenko, Yu.N. Novikov, E.-H. Lee, S.Y. Yoon, C.W. Kim. J. Appl. Phys. 96, 4293 (2004).
- [11] Г.В. Гадияк, М.С. Обрехт, С.П. Синица. Микроэлектроника **14**, 512 (1985).

- [12] H. Bachhofer, H. Reisinger, E. Bertagnolli. J. Appl. Phys. 89, 2791 (2001).
- [13] К.А. Насыров, Ю.Н. Новиков, В.А. Гриценко, С.Ю. Юн, Ч.В. Ким. Письма в ЖЭТФ 77, 455 (2003).
- [14] Z.A. Weinberg. Appl. Phys. Lett. 29, 617 (1976).
- [15] В.А. Гриценко, Е.Е. Меерсон. Микроэлектроника **12**, 580 (1983).
- [16] V.A. Gritsenko, E.E. Meerson, Yu.N. Morokov. Phys. Rev. B 57, R2081 (1997).
- [17] S.D. Tzeng, S. Gwo. J. Appl. Phys. 100, 023 711 (2006).
- [18] S.S. Makram-Ebeid, M. Lannoo. Phys. Rev. B 25, 6406 (1982).
- [19] V.A. Gritsenko, H. Wong, J.B. Xu, R.M. Kwok, I.P. Petrenko, B.A. Zaitsev, Yu.N. Morokov, Yu.N. Novikov. J. Appl. Phys. 86, 3234 (1999).
- [20] Н. Мотт, Э. Дэвис. Электронные процессы в некристаллических веществах. Мир, М. (1982), 660 с.